

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”）
本公司投资金额	106,000 万元
其他投资方合计投资金额	315,000 万元
投资进展情况	士兰集宏各股东完成实缴出资

一、对外投资基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。

公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。《投资合作协议》获相关权力机关批准后已生效。

2024 年 9 月 24 日，公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司、厦门新翼微成投资合伙企业（有限合伙）、厦门产投新翼科技投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作补充协议》（以下简称“《投资合作补充协议》”）。

上述对外投资事项具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日、5 月 23 日、6 月 7 日、8 月 15 日、9 月 26 日和 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2024-042、临 2024-044、临 2024-048、临 2024-056、临 2024-065 和临 2024-067。

二、对外投资进展情况

近日，上述各投资方根据《投资合作协议》及《投资合作补充协议》认缴的士兰集宏注册资本 421,000 万元已全部实缴到位。截至本公告披露日，士兰集宏最新的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	出资 方式
厦门半导体投资集团有限公司	100,000	100,000	23.7530	货币
厦门新翼微成投资合伙企业（有限合伙）	110,000	110,000	26.1283	货币
厦门产投新翼科技投资合伙企业（有限合伙）	105,000	105,000	24.9406	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	106,000	106,000	25.1781	货币
合计	421,000	421,000	100.00	-

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年6月13日